

INFORME N°1/2008 (01/02/2008)

EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES SISTEMA CONSTRUCTIVO TECNOPANEL

En relación con el sistema constructivo TECNOPANEL, para elementos estructurales en base a paneles de madera con alma de poliestireno de alta densidad, se ha tenido a la vista los siguientes antecedentes:

1. Carta de fecha 19 de Diciembre de 2007 del Sr. Francis Fenninger que incluye antecedentes del sistema constructivo TECNOPANEL.
2. Carta de fecha 24 de Enero de 2008 del Sr. Francis Fenninger con aclaraciones a observaciones realizadas en el proceso de revisión.
3. Memoria con descripción del sistema constructivo TECNOPANEL.
4. Anexos incluidos en la Memoria indicada en el punto anterior y que contienen los siguientes antecedentes:
  - a) Especificaciones Técnicas para construcción de viviendas con el sistema constructivo TECNOPANEL
  - b) Informes DICTUC N° 663205, de compresión, carga horizontal, flexión e impacto de paneles de OSB y poliestireno expandido, de espesor total 7,5 cm. TECNOPANEL.
  - c) Informes DICTUC N° 457001, de compresión, carga horizontal, flexión e impacto de paneles de OSB y poliestireno expandido, de espesor total 10 cm. TECNOPANEL.
  - d) Informes DICTUC N° 612955, de flexión de paneles prefabricados de espesor total de 21 cm. TECNOPANEL.
  - e) Informes DICTUC N° 672809, de flexión de paneles prefabricados de espesor total de 161 cm. TECNOPANEL.
  - f) Informe de ensayo IDIEM N° 374.265 y N° 417.404, sobre resistencia contra el fuego para paneles de 7,5 cm. TECNOPANEL
  - g) Informe de ensayo IDIEM N° 374.266, sobre resistencia contra el fuego para paneles de 8,5 cm. TECNOPANEL
  - h) Informe de ensayo IDIEM N° 374.267, sobre resistencia contra el fuego para paneles de 17,5 cm. TECNOPANEL
  - i) Informe de ensayo IDIEM N° 373.221, sobre medición de aislación acústica para paneles de 17,5 cm. TECNOPANEL
  - j) Informe de ensayo IDIEM N° 448.699-6, sobre medición de coeficiente de conductividad térmica de placas de OSB de 9.5 mm. de espesor.
  - k) Memoria de cálculo estructural de vivienda tipo, de 2 pisos.
  - l) Planos de arquitectura de vivienda tipo de 2 pisos.
  - m) Planos de estructuras de vivienda tipo de 2 pisos.
  - n) Planos de detalles constructivos.



Después de revisados los antecedentes presentados y verificados el cumplimiento de la exigencias planteadas en el instructivo sobre antecedentes para la aprobación de sistemas constructivos, y que el contenido de dichos antecedentes es técnicamente satisfactorio, se procede a informar favorablemente la solicitud de aprobación del sistema constructivo de nombre comercial TECNOPANEL, para ser aplicado en todo el país.

Los antecedentes que han permitido la aprobación del sistema citado permanecerán en custodia en el Departamento de Tecnologías de la Construcción de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional.

El presente informe no exime al sistema constructivo, de la presentación de los proyectos respectivos al momento de solicitar los permisos de edificación correspondiente y del cumplimiento de la normativa vigente.

  
DSH/MSZ

  
MARIA ESPERANZA AVILA VALENZUELA  
JEFE DIVISION TÉCNICA DE ESTUDIO  
Y FOMENTO HABITACIONAL (S)

PROHIBIDO SU USO Y PUBLICACIÓN